No, IS-9846B 来歷/REV. 仕 書 製 品 様 頁 1/4PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 7-11-'06 題: 9846B/9832Sシリーズ 0.5mmピッチ ボード トゥ ボード 可動コシクタ ISSUE DATE SUBJECT: SERIES 9846 B / 9832 S 0.5 mm pitch board to board floating Connector 8-22-'07 REVISED DATA

1.適用範囲

0.5mmピッチボード トゥ ボード コネクタに関する仕様及び性能上の必要事 項について規定する。

(貴社名:パイオニア株式会社殿)

2.形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。

適合プラグ : IMSA-9846B-***-GF 適合ソケット: IMSA-9832S-***-GF

3.定格

(1)最大定格電圧 : 50V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 0.3A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4.試験環境

特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35°C

25~85%RH 常湿

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO, LTD. series 9846B/9832S 0.5mm pitch board to board connector.

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached. (Applied for Gold plate product)

3.Rating

(1)Maximum rating voltage: 50 V (AC,DC)

(2)Maximum rating current: 0.3A

(3)Temperature range : −40~+105°C

4. Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition.

Ambient temperature : 15~35℃

Ambient humidity

: 25~85%RH

5.Performance

5.特性

5-1.電気的特性

5-1.Electrical performances

| No. | 項目/Items | 条件/Test conditions | 規格/specifications |
|-----|----------------------|--|---|
| 1 | 接触抵抗 | 短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル | 初期値: 60mΩ以下 |
| | Contact resistance | 抵抗計にて測定する。 | 各試験後:120mΩ以下 |
| | | It shall be measured by the dry electric circuit specified as | Initial : $60 \text{m} \Omega$ or below |
| | | follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency. | After each test: $120m\Omega$ or below |
| 2 | 耐電圧 | 隣接する極間にAC 250Vを1分間印加する。 | 絶縁破壊等異常のない事。 |
| | Dielectric | | Should not have any changes. |
| | withstanding | AC 250 voltage shall be applied for one minute to between next | |
| | voltage | terminals. | |
| 3 | 絶縁抵抗 | 隣接する極間に DC 200V を印加し、測定する。 | 初期値:100ΜΩ以上 |
| | Insulation | | Initial: $100 M\Omega$ or more |
| | resistance | It shall be measured when DC200V is applied to between next | |
| | | terminals. | |
| 4 | 温度上昇試験 | コネクタを嵌合した状態にて全極直列に接続し、最大許容電流を | 温度上昇:30℃以下 |
| | Raise of temperature | 通電した場合のコネクタの温度上昇を測定する。 | Raise of temperature: 30°C or below |
| | test | The connector shall be operated in the maximum raise of | |
| | | current and measured raise of the temperature at the | · |
| | | contact point. | |
| 5 | 外観 | 目視 | 有害となる割れ、剥がれ、ガタ |
| | | | 変形、変色等のない事。 |
| | Appearance | Visual | Should not have any flaw, scratch, |
| | | | discoloration and crushed. |

5-2 機械的特性 5-2. Functional Performance

| 3-2.1成1双F31寸1土 | | <u>5-2.Fun</u> | coonar i eriormance |
|----------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| No. | 項目/Items | 条件/Test conditions | 規格/specifications |
| 1 | ポストの保持力 | ポストに 25mm/分の速度で荷重を加え、ポストがベースより抜 | 1.96N以上 |
| | | け始めるまでの荷重を測定する。 | |
| | Post retention | It shall be pulled to the post at the speed of 25mm per | 1.96N or more. |
| | force | minute, and measured the force when the post begins to | |
| | | remove from the base. | |
| 2 | コンタクトの保持力 | コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが | 1.96N以上 |
| | | ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。 | |
| | Contact retention | It shall be pushed to the contact at the speed of 25mm per | 1.96N or more. |
| | force | minute, and measured the force when the contact begins to | |
| | | remove from the housing. | |
| 3 | 挿抜力 | ソケットとプラグを 25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の | 初期値にて/Initial(単極にて) |
| | | 荷重を測定する。 | 挿入力:1.47N 以下/極 |
| Insertion/extraction | | The socket and plug header shall be mated and unmated | 抜去力:0.098N 以上/極 |
| | force | at the speed of 25mm per minute and measured the force | Insertion force: 1.47N or |
| | | of insertion and extraction. | below / terminal |
| | , | | Extraction force: 0.098N or |
| | | | more / terminal |

| No. | IS-9846B | 来歷/REV. | (| 頁/Page | 2/4 |
|------|----------|-----------------|-----|----------|-----|
| 110. | ID UCTOB | /(0112/ 1011 11 | l t |) - Lugo | -/- |

| NT. | 1百日 /14 | 久丹 /Thank and ditions | 坦枚 /anaifications |
|-----|--|--|--|
| No. | 項目/Items | 条件/Test conditions | 規格/specifications |
| 4 | 挿抜耐久性 | ソケットとプラグを 25mm/分の速度で 30 回繰り返し挿抜を行ない、試験 | 120mΩ以下 |
| | | 後の接触抵抗を測定する。 | |
| | Insertion/extraction | The socket and plug shall be mated and unmated 30 times at the | $120\mathrm{m}\Omega$ or below |
| | endurance | speed of 25mm per minute and measured the contact resistance | · |
| | | after the test. | |
| 5 | 振動試験 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて、振幅1.5mm、振動周波数 | 試験中1μs以上の瞬断のない事。 |
| | | 10~55~10Hz/分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な3方向に各々 | 試験後:120mΩ以下 |
| | Vibration test | 2時間 計6時間 の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後 | |
| | • . | 接触抵抗を測定する。 | |
| | | The connector mated are unmated at 5 times mated is vibrated in | |
| | | the frequency range of 10~55~10Hz and in the constant vibration | Discontinuity : $1 \mu s$ or below |
| | | amplitude 1.5mm. This motion is applied for period of 6 hours in | After the test : $120 \mathrm{m}\Omega$ or |
| | one of 5 mathacetal perpendicular affections(2,1,2 axis) metaded | | below. |
| | | mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact | |
| | | current during the test and measured the contact resistance after | |
| | | the test. | |
| 6 | 衝擊試験 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて、治具に取付け,加速度 | 試験中1μs以上の瞬断のない事。 |
| | | 490m/s ² 、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回 | 試験後: 120 m Ω 以下 |
| | Shock test | 加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 | |
| | The connector mated are unmated at 5 times mated are installed | | Discontinuity : $1 \mu s$ or below |
| | in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of | | After the test : $120 \text{m}\Omega$ or |
| | multilateral 3 perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as | | below. |
| | | specified; acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration | . ' |
| | ŕ | of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current | |
| | | during the test and measured the contact resistance after the test | |

5-3.環境特性 5-3.Environmental performance

| 0-0.2 | 現村注 | ormance | |
|-------|---|--|---------------------------------|
| No. | 項目/Items | 条件/Test conditions | 規格/specifications |
| 1 | 耐熱性 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に | 120mΩ以下 |
| | | 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 | |
| | Heat resistance | The connector mated are unmated at 5 times mated is exposed in | $120 \mathrm{m}\Omega$ or below |
| | | the heat chamber 105±2°C for 96 hours. It shall be measured | |
| | | the contact resistance after the test. | |
| 2 | 耐湿性 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~ | 120mΩ以下 |
| | | 95%RH の雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 | |
| | Humidity | The connector mated are unmated at 5 times mated is exposed in | $120 \mathrm{m}\Omega$ or below |
| | | he humidity chamber $60\pm2^{\circ}$ C, $90\sim95\%$ RH for 96 hours. It shall be | |
| | | measured the contact resistance after the test. | |
| 3 | 塩水噴霧試験 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて、槽内温度35±2℃、濃度5±1% | 120mΩ以下 |
| | | の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 | |
| 1 | Salt spray test | The connector mated are unmated at 5 times mated is exposed in the salt spray chamber $35\pm2^{\circ}$ C, $5\pm1^{\circ}$ 8 salt density for 48 hours. | $120 \mathrm{m}\Omega$ or below |
| 1 | | · | |
| | | · | |
| 4 | S O ₂ ガス試験 | コネクタを 5 回挿抜後、嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75% | 120mΩ以下 |
| | | RH、濃度 10±3ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定 | |
| | SO_2 gas test | する。 | $120 \mathrm{m}\Omega$ or below |
| | | The connector mated are unmated at 5 times mated is exposed in | |
| | | the $S O_2$ gas chamber $40\pm2\%,75\%$ RH 10 ± 3 ppm for 96 hours. It | |
| | · | shall be measured the contact resistance after the test. | |
| 5 | H2Sガス試験 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 | 120mΩ以下 |
| | 75% RH、濃度 3 ± 1 ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触 H_2 S gas test 測定する。 | | |
| | H ₂ S gas test | $120 \mathrm{m}\Omega$ or below | |
| | | The connector mated are unmated at 5 times mated is exposed | |
| | | in the H ₂ S gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C, 75% RH 3 ± 1 ppm for 96 hours. It | |
| | | shall be measured the contact resistance after the test. | |

| | No. | IS-9846B | 来歷/REV. | 1 | 頁/Page | 3/4 |
|--|-----|----------|---------|---|--------|-----|
|--|-----|----------|---------|---|--------|-----|

| No. | 項目/Items | 条件/Test conditions | 規格/specifications |
|-----|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 6 | 冷熱衝撃試験 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 | 120mΩ以下 |
| | Thermal shock test | The connector mated are unmated at 5 times mated is exposed 10 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test. | $120 \mathrm{m}\Omega$ or below |
| | | $+85\pm2$ C Ambient temperature -55 ± 3 C $30min$ $30min$ | |
| 7 | 温湿度サイクル試験 | コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 | 120mΩ以下 |
| - | Humidity Resistance (cycling) | The connector mated are unmated at 5 times mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test. | 120m Ω or below |
| | | $+80\pm2^{\circ}$ $90\sim95\%RH$ $-20\pm3^{\circ}$ $\iff 2h \implies \iff 2h \implies \iff 2h \implies$ $= 2h \implies$ $= 1 \text{ cycle}$ | |

| No. 項目/Items | 5-4.その他の特性 | | その他の特性 | 5-4.Other performance | | | |
|--|------------|--------------|----------------|---|------------------|--|--|
| 第フリー槽に3±0.5 移浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C、3±0.5s. 2 半田副熟性 Resistance to soldering heat in the following conditions. (1) リフロー回数介umber of reflow time: 2 2 250°CMAX(**) 一温度力eak temperature) 10sMAX. 230°CMIN. (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (230°CMIN. (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (230°CMIN. (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (230°CMIN. (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (60sMAX.) 小 (7禁 130~180°C) (pre-heat: from 130 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/In case of manual soldering. 半日慶温度 / temperature : 350±10°C 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚/ thickness : t=1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半日慶温度 / temperature : 260±5°C 予教 / pre-heat : 120±10°C 120s 時間 / time : 5±1.0s | | No. 項目/Items | | | | | |
| Solderability The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C、3±0.5s. **** *** *** ** ** ** ** ** | . [| 1 | 半田付け性 | コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の | 浸した面積の 95%以上に半田が | | |
| Fice solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s. free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s. more of the area that is dipped into the solder bath. 端子のガラタ。剥け等異常のない事。 ボール・カラタ・割り等異常のない事。 ボール・カラタ・割り等異常のない事。 ボール・カラタ・割り等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack. リフロー回数/number of reflow time: 2 250℃MAX化・ル温度/Peak temperature) 10sMAX. 230℃MIN. (60sMAX). (60sMAX). (60sMAX). (60sMAX). (60sMAX). (60sMAX). (60sMAX). (60sMAX). (60sMax). (7素 130~180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田砂場合/In case of manual soldering. 半田砂温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 5±1.0s ま板厚/thickness : t=1.6 mm (3)ディップの場合/In case of dip 半田砂温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | į | | | 鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。 | むらなく付着する事。 | | |
| #田耐熱性 Resistance to soldering heat to soldering heat in the following conditions. (1) リアーの場合/In case of reflow リフロー回数number of reflow time: 2 250℃MAX(* - か温度/Peak temperature) 10sMAX. 230℃MIN. (60sMAX.)△ (子熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上節の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鰻温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時門 / time : 3.5±0.5s 基板厚/thickness : t = 1.6 mm (3)ディップの場合/In case of dip 半田鰻温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | Solderability | The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb | | | |
| The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. (1) リカーの場合 / In case of reflow リフロー回数/number of reflow time: 2 250℃MAX(* 一力温度/Peak temperature) 10sMAX. | | | | free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C, 3 ± 0.5 s. | | | |
| Resistance to soldering heat in the following conditions. (1) リワーの場合 / In case of reflow リフロー回数/number of reflow time: 2 250℃MAX(* - 小温度/Peak temperature) 10sMAX. (230℃MIN. (60sMAX.)△ (60sMAX.)△ (60sMAX.)△ (230℃MIN. | | | | | | | |
| the following conditions. (1) リカーの場合 / In case of reflow ロリフロー回数/number of reflow time: 2 250°CMAX(ビーが温度/Peak temperature) 10sMAX. (子熱 130~180°C) (pre-heat: from 130 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合 / In case of manual soldering. 半田鑁温度 / temperature : 350±10°C 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚 / thickness : t = 1.6 mm (3)ディップの場合 / In case of dip 半田鑁温度 / temperature : 260±5°C 予熱 / pre-heat : 120±10°C 120s 時間 / time : 5±1.0s | | 2 | | | 1 1 | | |
| (1) リアロー回数/number of reflow time: 2 250℃MAX(t²-ウ温度/Peak temperature) 10sMAX. (子熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鰻温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚 / thickness : t =1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鰻温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | | | | | |
| リフロー回数number of reflow time: 2 250℃MAX(t* - 小温度/Peak temperature) 10sMAX. (子熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚 / thickness : t = 1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | soldering heat | | | | |
| 250℃MAX(ピーウ温度/Peak temperature) 10sMAX. (予熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板度 / thickness : t = 1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | | | crack. | | |
| 230°CMIN. (60sMAX.) (| | | | | | | |
| (子熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚 / thickness : t =1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | | | | | |
| (予熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚/thickness : t=1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | • | IUsMAX. | · | | |
| (予熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚/thickness : t=1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | 1 | | | | | | |
| (予熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚/thickness : t=1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | | | | | |
| (予熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚/thickness : t=1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | ļ | | | 230°CMIN. | | | |
| (予熱 130~180°C) (pre-heat: from 130 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10°C 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚/thickness : t = 1.6 mm (3)ディップの場合/In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5°C 予熱 / pre-heat : 120±10°C 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | | | | | |
| (予熱 130~180℃) (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. | | | | | V | | |
| (pre-heat: from 130 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚/thickness : t=1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | | | | | |
| 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : $350\pm10^{\circ}$ C 浸漬時間 / time : 3.5 ± 0.5 s 基板厚/thickness : $t=1.6$ mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : $260\pm5^{\circ}$ C 予熱 / pre-heat : $120\pm10^{\circ}$ C 120s 時間 / time : 5 ± 1.0 s | | | | (予熱 130~180℃) | | | |
| The temperature shall be measured on the surface of the product (2) 手半田の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : $350\pm10^{\circ}$ C 浸漬時間 / time : 3.5 ± 0.5 s 基板厚/thickness : $t=1.6$ mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : $260\pm5^{\circ}$ C 予熱 / pre-heat : $120\pm10^{\circ}$ C 120s 時間 / time : 5 ± 1.0 s | - | | | (pre-heat: from 130 to 180° C) | | | |
| (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. | | | 4 | 温度は製品上面の温度とする。 | | | |
| 半田鏝温度 / temperature $: 350\pm10^{\circ}$ C 浸漬時間 / time $: 3.5\pm0.5$ s 基板厚/thickness $: t=1.6$ mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature $: 260\pm5^{\circ}$ C 予熱 / pre-heat $: 120\pm10^{\circ}$ C 120s 時間 / time $: 5\pm1.0$ s | 1 | | | The temperature shall be measured on the surface of the product | | | |
| 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s 基板厚 / thickness : t = 1.6 mm (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | ı | | | (2)手半田の場合/ In case of manual soldering. | | | |
| 基板厚/thickness : $t=1.6$ mm (3)ディップの場合/In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260 ± 5 \mathbb{C} 予熱 / pre-heat : 120 ± 10 \mathbb{C} 120s 時間 / time : 5 ± 1.0 s | - | | | 半田鏝温度 / temperature :350±10℃ | | | |
| (3)ディップの場合/ In case of dip 半田鏝温度 / temperature : 260±5℃ 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | 1 | | | 浸漬時間 / time : 3.5±0.5s | | | |
| 半田鏝温度 / temperature : 260 ± 5 \mathbb{C} | | | | 基板厚/thickness : t=1.6 mm | | | |
| 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s 時間 / time : 5±1.0s | | | | (3)ディップの場合/ In case of dip | , | | |
| 時間 / time : 5±1.0s | | | | 半田鏝温度 / temperature :260±5℃ | | | |
| 時間 / time : 5±1.0s | | | | 予熱 / pre-heat : 120±10℃ 120s | | | |
| 基板厚/thickness : t=1.6 mm | | | | | | | |
| | | | | 基板厚/thickness : t = 1.6 mm | | | |

No. IS-9846B 来歷/REV. | 頁/Page 4/4

6.その他

6-1. 保存保管条件

室内で−10~+40℃の温度、75%RH以下の相対湿度の保管条件にて1年間。

6-2. GGP-001 について

本品はパイオニアグループ規定 GGP-001 に準拠していること。

6-3. 和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

6.0thers

6-1.Storage condition

Shall be storaged in the house at $-10 \sim +40$ °C, 75%RH or less. 1 year from product day.

6-2.About GGP-001

These goods are to be based on the Pioneer group regulation GGP-001.

6-3.Difference is between Japanese and English

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, Priority shall be given to Japanese on

制定•改訂記録

| | | | | No. | IS- | -9846B | 頁 | 0/4 |
|----|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------|--------|-----|-----|
| 記号 | 年月日 | 記 | 事 | | 通知書No. | 承 認 | 照査 | 担当 |
| 0 | 05/7/11 | 新規(パイオニア | 限定) | | 2249/ | 大人 | (1) | 松断 |
| 1 | 07/8/22 | 5-4.2 170.素件 | 230℃ HIN 時間 = 6 | OSHIN>60sMX表页 | 00000 | 吉河 | 松崎 | 行式 |
| | / / | | | | | , | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| ļ | / / | | | | | | | |
| | | | | | | | | ļ |
| | / / | | | | | | | |
| | / / / | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| · | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | <u>′</u> / / | | | | | | | |
| | / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | - / , / | | | | | | | |
| | / / | | | | | | | |
| | / " / | | | | | | | |